

Title (en)
Cooking device

Title (de)
Kocheinrichtung

Title (fr)
Appareil de cuisson

Publication
EP 2775787 A1 20140910 (DE)

Application
EP 14401011 A 20140203

Priority
DE 102013102110 A 20130304

Abstract (en)
The device (1) comprises a cooking area (11) with a cooking point (21), a heating device (2) for heating a cooking zone (31) and a sensor device (3) for detecting a physical quantity in a detection area (83). The cooking area comprises a support element (5) for supporting a suitable food container. The sensor device is partially arranged below the support element. A sealing element is provided for thermal insulation such that a portion of sealing element is arranged between a portion of the support element and a portion of the sensor device.

Abstract (de)
Kocheinrichtung (1), umfassend ein Kochfeld (11) mit wenigstens einer Kochstelle (21) und mit einer zur Beheizung wenigstens eines Kochbereiches (31) vorgesehenen Heizeinrichtung (2) sowie mit einer Sensoreinrichtung (3) zur Erfassung wenigstens einer physikalischen Größe in einem Erfassungsbereich (83). Das Kochfeld (11) weist eine Trägereinrichtung (5) zum Positionieren wenigstens eines Gargutbehälters auf. Die Sensoreinrichtung (3) ist in Einbaulage des Kochfeldes (11) unterhalb der Trägereinrichtung (5) angeordnet. Es ist eine Dichtungseinrichtung (6) zur thermischen Isolierung vorgesehen. Die Dichtungseinrichtung (6) ist zwischen der Trägereinrichtung (5) und der Sensoreinrichtung (3) angeordnet.

IPC 8 full level
F24C 7/08 (2006.01); **H05B 1/02** (2006.01); **H05B 6/06** (2006.01); **H05B 6/12** (2006.01)

CPC (source: EP)
F24C 7/083 (2013.01); **H05B 1/0266** (2013.01); **H05B 6/062** (2013.01); **H05B 2213/07** (2013.01)

Citation (applicant)
• DE 102004002058 B3 20050908 - MIELE & CIE [DE]
• WO 2008148529 A1 20081211 - MIELE & CIE [DE], et al
• DE 102007013839 A1 20080925 - BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]

Citation (search report)
• [X] JP 2004095314 A 20040325 - MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
• [X] JP 2004063451 A 20040226 - ISHIZUKA ELECTRONICS CORP
• [A] WO 2008155922 A1 20081224 - PANASONIC CORP [JP], et al
• [A] EP 1562405 A1 20050810 - MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]
• [A] JP 2009224340 A 20091001 - PANASONIC CORP
• [A] JP 2004227976 A 20040812 - MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Cited by
CN109373367A; EP3722672A1

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2775787 A1 20140910; EP 2775787 B1 20170621; DE 102013102110 A1 20140918; ES 2636798 T3 20171009

DOCDB simple family (application)
EP 14401011 A 20140203; DE 102013102110 A 20130304; ES 14401011 T 20140203